



Brüssel, den 3. Juni 2026
(OR. en)

Interinstitutionelles Dossier:
2026/0139 (COD)

10094/26
ADD 6

COMPET 666
IND 388
MI 582
RC 13
RECH 258
TELECOM 290
FIN 812
CADREFIN 262
CODEC 1088
IA 149

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	3. Juni 2026
Empfänger:	Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	SWD(2026) 505 final
Betr.:	ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN BERICHT ÜBER DIE FOLGENABSCHÄTZUNG (ZUSAMMENFASSUNG) [...] Begleitunterlage zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des Halbleiterökosystems der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

Die Delegationen erhalten als Anlage das Dokument SWD(2026) 505 final.

Anl.: SWD(2026) 505 final



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 3.6.2026
SWD(2026) 505 final

ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN
BERICHT ÜBER DIE FOLGENABSCHÄTZUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

[...]

Begleitunterlage zum

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über einen Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des Halbleiterökosystems der Union
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

{COM(2026) 504 final} - {SEC(2026) 504 final} - {SWD(2026) 504 final}

Ermittlung des Problems und EU-Dimension

Halbleiter stellen eine strategische grundlegende Technologie für den digitalen Wandel, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die Verteidigung und die wirtschaftliche Sicherheit der Union dar. Im Draghi-Bericht wurde betont, dass Investitionen in strategische Technologien wie Halbleiter für die Wettbewerbsfähigkeit der EU erforderlich sind, und die Ausarbeitung einer umfassenden Halbleiterstrategie der EU gefordert. Die Bewertung des ersten Chip-Gesetzes und die Problemanalyse der Folgenabschätzung zur Chip-Verordnung 2.0 zeigen, dass die EU trotz erheblicher Fortschritte, die dank des ersten Chip-Gesetzes erzielt wurden, dennoch weiterhin mit strukturellen Schwachstellen entlang der gesamten Halbleiterwertschöpfungskette konfrontiert ist. Diese Schwachstellen ergeben sich aus der übermäßigen Abhängigkeit von einer begrenzten Zahl von Anbietern aus Drittländern für den Entwurf und die Fertigung von Halbleitern. So deckt die Fertigung von Halbleitern in der EU lediglich ein Fünftel ihres Verbrauchs, und die wichtigsten nachgelagerten Industriezweige sind weiterhin externen Versorgungsschocks ausgesetzt. Darüber hinaus ist die EU nach wie vor nicht ausreichend in der Lage, Lieferstörungen zu antizipieren, zu überwachen und entsprechend zu reagieren, was zu einer unzureichenden Krisenvorsorge führt. Die bestehenden Mechanismen des Chip-Gesetzes beruhen – außerhalb von Krisensituationen – auf einem freiwilligen Informationsaustausch und haben nicht dazu geführt, dass aktuelle und umfassende Informationen über die Lieferkette erfasst werden, die für eine wirksame Krisenvorsorge erforderlich wären.

Der Halbleitersektor zeichnet sich durch eine hohe Kapitalintensität, langfristige Investitionen, ein hohes technologisches Risiko und starke Netzeffekte aus, was ein strukturelles Marktversagen nach sich zieht. Dies äußert sich in unzureichenden Investitionen in Fertigungsanlagen, eine begrenzte Nachfrage nach fortgeschrittenen Technologien und unzureichenden Informationen über die Lieferkette, die jedoch zur Antizipation und Behebung von Störungen erforderlich sind. Fragmentierte nationale Maßnahmen beeinträchtigen die Wirksamkeit öffentlicher Interventionen.

Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters der Halbleiterlieferketten, potenzieller unionsweiter Störungen und des Umfangs an Investitionen, die erforderlich sind, um mit großen öffentlichen Förderprogrammen von Drittländern Schritt halten zu können, betreffen die Probleme eindeutig die gesamte EU und können von den Mitgliedstaaten einzeln nicht wirksam bewältigt werden.

Ziel der Initiative

Ziel der Chip-Verordnung 2.0 ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Ökosystems zu steigern, die technologische Souveränität und die Resilienz zu stärken und die Krisenvorsorge zu verbessern, um so die Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche Sicherheit der EU zu gewährleisten. Die Initiative baut auf dem ersten Chip-Gesetz auf und zielt darauf ab, diese Schwächen und Herausforderungen anzugehen, indem

- die Kapazitäten und die Versorgungssicherheit der EU in Bezug auf handelsübliche und fortgeschrittene Halbleiter, einschließlich KI-Chips, verbessert werden,

- ein starker Anwendermarkt für alle wichtigen Industriezweige entwickelt wird und
- die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten für die Krisenvorsorge und Krisenreaktion ausgebaut werden.

Bewertete Optionen und bevorzugte Option

In der Folgenabschätzung werden ein Basisszenario und davon ausgehend ehrgeizigere Politikoptionen bewertet, die den unterschiedlichen Grad der EU-Intervention widerspiegeln. Die Optionen reichen von Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen bis hin zu einem umfassenderen und strategischeren Ansatz.

Die bevorzugte Option („Strategische Souveränität“) würde das bestehende Chip-Gesetz stärken, indem sowohl horizontale als auch gezieltere vertikale Instrumente kombiniert würden. Zu den horizontalen Maßnahmen gehören vermehrte FEI-Unterstützung, Erläuterungen zum Rahmen für Neuartiges, beschleunigte Genehmigungsverfahren, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Halbleiterregionen durch das Gütesiegel für Halbleiterexzellenzregionen, die Einrichtung einer Unternehmensplattform zur Verbesserung der Transparenz und Resilienz, Auskunftersuchen – wenn keine Krisenstufe ausgerufen ist – und verstärkte Investitionen in Kompetenzen. Zu den stärker vertikal ausgerichteten Maßnahmen zählen strategische Projekte auf EU-Ebene und nachfrageseitige Maßnahmen wie die innovationsfördernde Auftragsvergabe, „Lab-to-Fab“-Beschleuniger und die Schaffung von Anreizen für inländische Chips oder ähnliche Vorkehrungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.

Diese Option bietet die wirksamste und verhältnismäßigste Antwort auf die festgestellten Probleme, wahrt gleichzeitig die Subsidiarität und hält den Verwaltungsaufwand möglichst gering. Damit wird auf die Ergebnisse der Bewertung reagiert, in der eine stärkere Integration von FuI- und industriellen Einführungstätigkeiten, Wege einer rascheren Industrialisierung und wirksamere Mechanismen zur Gewinnung von Erkenntnissen über Lieferketten gefordert werden.

Unterstützung durch die Interessenträger

Die Konsultationen zeigen eine breite Unterstützung für einen verstärkten Ansatz auf EU-Ebene. Interessenträger aller Gruppen betrachten das bisherige Chip-Gesetz als eine zeitnahe und notwendige Reaktion, eine weitere Stärkung wird aber nach wie vor als erforderlich angesehen. Halbleiterhersteller, Lieferanten von Ausrüstung und Werkstoffen sowie Entwurfsunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen befürworten eine stärkere Koordinierung und einen besseren Zugang zu gemeinsamen Infrastrukturen. KMU, Start-ups und Scale-ups heben die Bedeutung nachfrageseitiger Maßnahmen hervor.

Die Mitgliedstaaten sprechen sich für eine stärkere Koordinierung aus und betonen, dass die Sicherheit der Lieferkette und die Krisenvorsorge verbessert werden müssen. Die Interessenträger unterstreichen auch die Notwendigkeit einer klaren EU-Strategie zur Aufrechterhaltung der Offenheit in der internationalen Zusammenarbeit.

Nutzen und Kosten der bevorzugten Option

Die bevorzugte Option dürfte gegenüber dem Basisszenario wirtschaftliche, technologische und strategische Vorteile mit sich bringen, insbesondere durch die Bereitstellung der Instrumente, die für Investitionen in fortgeschrittene Halbleiterfertigung, Entwurfsökosysteme und Packaging in Europa und für die Fortsetzung der Investitionen in innovative handelsübliche Halbleiter erforderlich sind. Hierzu zählen eine höhere Hebelwirkung auf private Investitionen, geringere öffentliche Investitionen und ein geringeres Auslastungsrisiko bei fortgeschrittenen Anlagen, beschleunigte Wege für die Markteinführung von Innovationen, eine Stärkung der Fertigung und des Entwurfs in der EU sowie eine verbesserte Resilienz der Lieferketten. Die Bewertung bestätigt, dass Investitionen im Rahmen des bisherigen Chip-Gesetzes erhebliches privates Kapital mobilisiert und die Attraktivität der EU als Investitionsstandort erhöht haben.

Die öffentlichen Kosten beziehen sich in erster Linie auf erhöhte Finanzierungszusagen von der EU und den Mitgliedstaaten für strategische Projekte, FEI-Unterstützung und Governance-Strukturen. Die Kosten für den Privatsektor ergeben sich hauptsächlich aus Beteiligungsanforderungen und Verpflichtungen zum Informationsaustausch, die so gestaltet sind, dass sie verhältnismäßig sind und KMU weitgehend ausklammern. Insgesamt überwiegen die erwarteten Vorteile für die Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Versorgungssicherheit die Kosten auf mittlere bis lange Sicht.

Auswirkungen auf KMU und Wettbewerbsfähigkeit

Die bevorzugte Option dürfte sich positiv auf KMU auswirken, da die Halbleiterindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ein Netzwerk hoch spezialisierter KMU angewiesen ist. Verstärkte FEI-Zusammenarbeit, strategische Projekte, innovationsfördernde Auftragsvergabe und Anreize für die Beschaffung inländischer Chips schaffen Nachfrage und kommen insbesondere den auf Chipentwurf spezialisierte KMU ohne eigene Fertigung zugute.

Aus wettbewerblicher Sicht stärkt die Chip-Verordnung 2.0 die Halbleiterwertschöpfungskette der EU. Durch die Verringerung von Abhängigkeiten und die Förderung der industriellen Ausweitung verbessert die Initiative die Wettbewerbsfähigkeit der EU insgesamt und der nachgelagerten Wirtschaftszweige. Die Bewertung bestätigt, dass ein Tätigwerden der EU weiterhin von entscheidender Bedeutung ist, damit KMU in einem kapitalintensiven und globalisierten Sektor wettbewerbsfähig sind.

Andere nennenswerte Auswirkungen

Die Umweltauswirkungen stehen im Zusammenhang mit höheren Fertigungskapazitäten und einer höheren Ressourcennutzung. Die Initiative unterstützt den Einsatz energieeffizienter Technologien und nachhaltiger Fertigungsverfahren und trägt so zur Verfolgung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele der EU bei.

Zu den sozialen Auswirkungen gehören die Schaffung hoch qualifizierter Arbeitsplätze, die Stärkung regionaler Innovationsökosysteme und die steigende Nachfrage nach

fortgeschrittenen Kompetenzen. Eine erhöhte Versorgungssicherheit kommt kritischen Sektoren wie Automobilindustrie, industrielle Automatisierung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Luftfahrt- und Weltraumindustrie, Sicherheit, Verteidigung und KI-Infrastruktur zugute und trägt zur gesellschaftlichen Resilienz der EU bei.

Die Chip-Verordnung 2.0 enthält Vereinfachungsmaßnahmen, die darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand zu verringern, die Berechenbarkeit zu erhöhen und die Umsetzung zu beschleunigen. Aus den Konsultationen der Interessenträger und den Ergebnissen der Bewertung geht hervor, dass die Komplexität des Verfahrens, die langen Fristen und der Verwaltungsaufwand wesentliche Hemmnisse für Wirksamkeit und Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Angemahnt werden verkürzte Genehmigungsverfahren für Fertigungsanlagen, mehr Rechtssicherheit in Bezug auf den Anwendungsbereich und besser abgestimmte Verfahren für die Ausweisung von Projekten für Neuartiges und von strategischen Projekten.

Weiterverfolgung

Die Kommission sollte innerhalb von vier bis sechs Jahren nach Umsetzung der Initiative eine Bewertung vornehmen. Erforderlichenfalls sollten der Bewertung Vorschläge zur Anpassung oder Stärkung des Rahmens unter Berücksichtigung neuer technologischer und geopolitischer Entwicklungen beigelegt werden.